

合同说明

关于国家重点研发计划课题《微分型及深低温读出电路》(编号: 2021YFA0715503) 中芯片流片加工服务, 选择合作单位为: 中关村芯园(北京)有限公司。该公司 2015 年成立, 由中关村发展集团控股, 是国内知名芯片公共技术服务的平台公司, 是台积电(TSMC)国内的主要代理之一, 与北京大学有长期的合作历史。近两年由于全球芯片产业产能紧张, 大量芯片代工厂流片价格暴涨、加工周期延长, 严重影响课题进度。中关村芯园所提供的 TSMC 0.18 UM 工艺流片加工周期较短, 报价相比同类公司经济性好。所以计划选择与该合作单位签订流片加工服务合同, 特此说明。

项目负责人: 

合同说明

关于国家重点研发计划课题《无线自供能与可充电芯片研究》(编号: 2019YFB2204902) 中芯片流片加工服务, 选择合作单位为: 中关村芯园(北京)有限公司。该公司 2015 年成立, 由中关村发展集团控股, 是国内知名芯片公共技术服务的平台公司, 是台积电(TSMC)国内的主要代理之一, 与北京大学有长期的合作历史。近两年由于全球芯片产业产能紧张, 大量芯片代工厂流片价格暴涨、加工周期延长, 严重影响课题进度。中关村芯园所提供的 TSMC 0.18 UM 工艺流片加工周期较短, 报价相比同类公司经济性好。所以计划选择与该合作单位签订流片加工服务合同, 特此说明。

项目负责人: 张作聪

合同说明

关于国家自然科学基金委员会资助项目面向自动驾驶的红外热成像传感器非均匀性校正技术研究（课题编号：61973008）中芯片流片加工服务，选择合作单位为：中关村芯园（北京）有限公司，该项目预算书有载明合同受托方为中关村芯园（北京）有限公司。